

646547-1 AKTIV

Z-PACK | Z-PACK 2mm HM

Interne TE-Nummer 646547-1

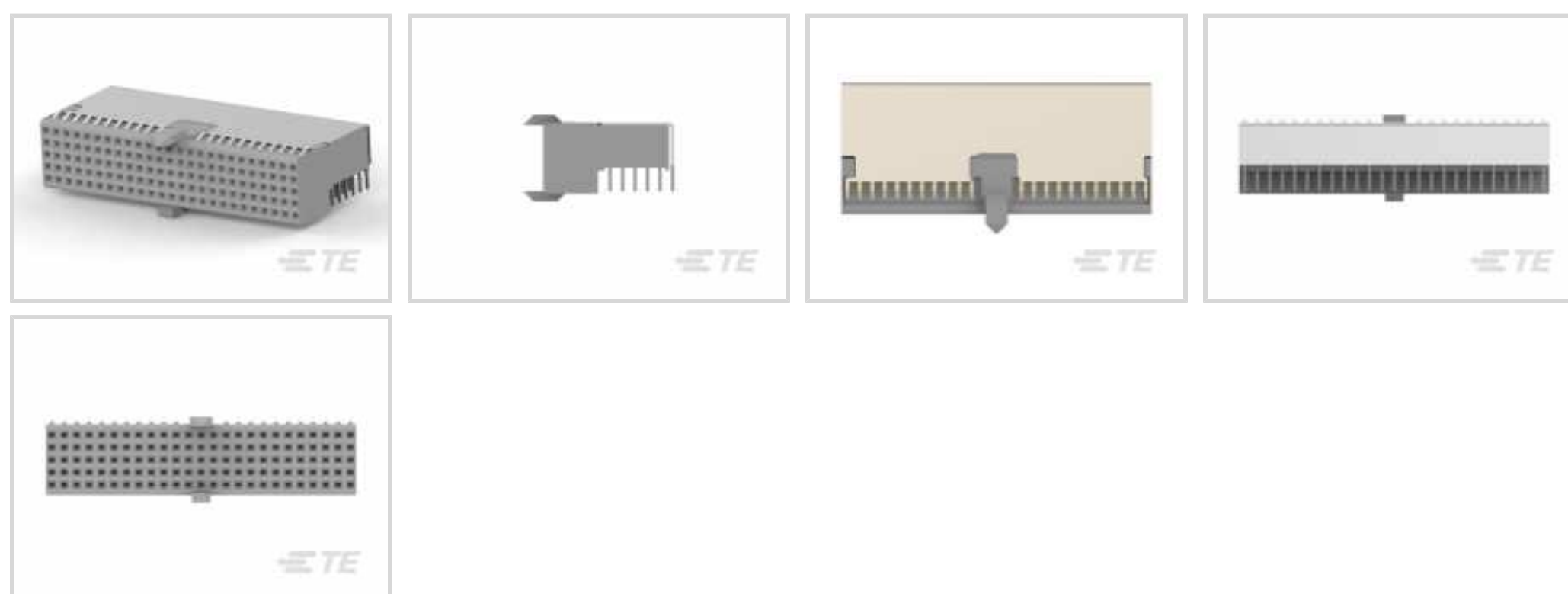
Hard Metric Backplane Connectors, PCB Mount Receptacle, ≤ 1 Gb/s, 25 Column, 5 Row, Mezzanine, Board-to-Board, 125 Position, Z-PACK 2mm HM

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Harte metrische Backplane-Steckverbinder >

HM Buchsensteckverbinder: Herkömmliche Backplane-Steckverbinder, Koplanar, 2 mm



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Buchse für die Leiterplattenmontage**

Datenrate: ≤ 1 Gb/s

Spaltenanzahl: 25

Zeilenanzahl: 5

Backplane-Architektur: **Mezzanine**

[Alle HM Buchsensteckverbinder: Herkömmliche Backplane-Steckverbinder, Koplanar, 2 mm \(48\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Backplane-Schnittstellentyp	2 mm HM
PCB-Steckverbindermontagetyp	Buchse für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Bestückte Zeilen	Voll bestückt
Anzahl der Signalpositionen	125
Spaltenanzahl	25
Zeilenanzahl	5
Backplane-Architektur	Mezzanine
Anzahl von Positionen	125

Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
-------------------------------------	----------------

Signalmerkmale

Übersprechversion	Standard
-------------------	----------

Datenrate	≤1 Gb/s
-----------	---------

Kontaktmerkmale

Durchführungspostenlänge	3.3 mm
--------------------------	--------

Kontakttyp	Stecksockel
------------	-------------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn-Blei
---	-----------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

CompactPCI-Bezeichnung	Keine
------------------------	-------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
--	------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm[30 µin]
---	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A
--------------------------	-------

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
-------------------------------------	-------------------------------

Montage und Anschluss technik

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Polyester – GF
-----------------	----------------

Raster	2 mm[.078 in]
--------	---------------

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

Abmessungen

Backplane Modullänge	49.9 mm
----------------------	---------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Ja
-----------	----

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt	Nein
------------------------------------	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	10
Verpackungsmethode	Tube

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Nicht konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) SVHC > Schwellenwert: Pb (13% in Component Part) Sicherheitshinweise: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | Z-PACK 2mm HM



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

Z-PACK A-B 25 COLUMN SHLD ASSY

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_646547-1_G.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_646547-1_G.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_646547-1_G.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen



Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch